

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年9月10日 (10.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/076533 A1

(51) 国際特許分類7: C08G 77/06, C01B 33/18

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/002130

(22) 国際出願日: 2004年2月24日 (24.02.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-50417 2003年2月27日 (27.02.2003) JP
特願2003-67777 2003年3月13日 (13.03.2003) JP
特願2003-135245 2003年5月14日 (14.05.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 宇部日東化成株式会社 (UBE NITTO KASEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目1番7号 Tokyo (JP).

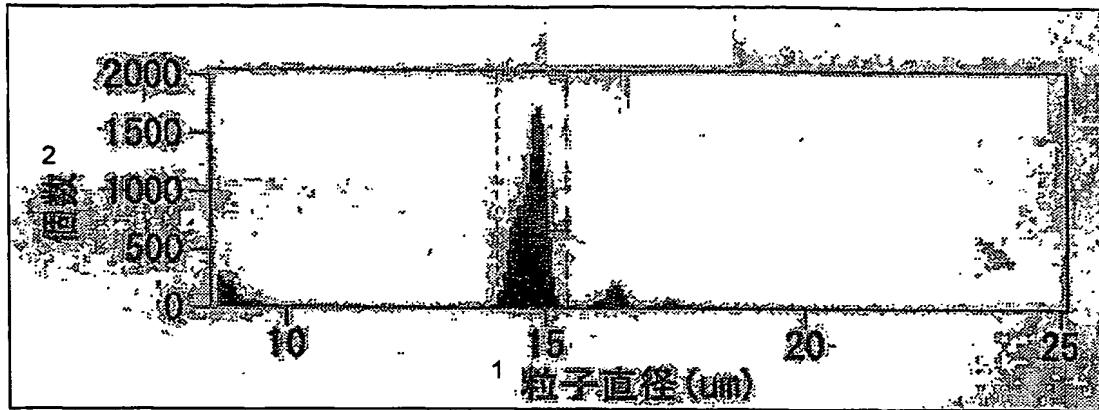
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 鈴木 太郎

(54) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

(続葉有)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING POLYORGANOSILOXANE PARTICLES AND FOR PRODUCING SILICA PARTICLES

(54) 発明の名称: ポリオルガノシロキサン粒子の製造方法およびシリカ粒子の製造方法



1...PARTICLE DIAMETER (μm)
2...NUMBER OF PIECES

WO 2004/076533 A1

(57) Abstract: A method for producing polyorganosiloxane particles wherein such particles are produced through a step of subjecting a silicon compound having a non-hydrolyzable group and a hydrolyzable alkoxy group both bonded to a silicon atom to hydrolysis and condensation in the presence of a catalyst, to thereby form seed particles comprising polyorganosiloxane particles and prepare a fluid containing above seed particles and a step of adding an aqueous fluid for enhancing the particle diameter thereof comprising the above silicon compound or a hydrolyzate thereof to said fluid containing seed particles, characterized in that it comprises measuring a particle diameter continuously or at predetermined periods of time in the above seed particle growth step and stopping the reaction at the time when an objective particle diameter is achieved.

(続葉有)

BEST AVAILABLE COPY



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明は、非加水分解性基と加水分解性のアルコキシル基がケイ素原子に結合したケイ素化合物を触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程、および該シード粒子含有溶液に前記ケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液を添加して、前記シード粒子の成長を行う工程を経てポリオルガノシロキサン粒子を製造するに際し、前記シード粒子成長工程において、連続的あるいは一定時間おきに粒径を測定し、目的粒径に達した時点で反応を停止させることにより、ポリオルガノシロキサン粒子を製造する方法を提供する。

明細書

ポリオルガノシロキサン粒子の製造方法およびシリカ粒子の製造方法

5

技術分野

本発明は、ポリオルガノシロキサン粒子の製造方法およびシリカ粒子の製造方法に関する。

10 背景技術

従来、粒径分布が単分散状のシリカ粒子（以下、単に単分散シリカ粒子ということがある）は、各種充填材やセラミックス原料などとして有用であることが知られているが、特に最近では、液晶表示装置のスペーサとしての用途が注目され、使用され始めている。

15 液晶表示装置のスペーサには、従来ガラスファイバーチップあるいは合成樹脂の微粒子が用いられてきた。しかしながらガラスファイバーチップはファイバー径精度には優れているものの、その長さにばらつきが大きく、余りに長いものは目視され画質を低下するおそれがあり、またその端部が鋭利であるため、基板上に成形された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいは電気素子などを傷つけてしまうおそれがある。また、合成樹脂の微粒子は粒径精度が劣るため、液晶表示装置用スペーサとして要求される性能を満たし得ないことがある。したがって、より高度のギャップ精度を要求される場合には、粒径精度が良く、かつ球形で、基板上に形成された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいはITO導電膜等の電気素子を傷つけるおそれのないものが要求される。

これらの要求を満たすものとして、シリコンアルコキシドを加水分解・重縮合することによって得られたシリカ粒子が提案されている。このシリカ粒子は、

（1）純度が高く、溶出成分による液晶への影響が少ない

(2) 粒径精度が良く、下式

$$C\ V\ (\%) = [\text{微粒子径の標準偏差} (\mu\text{m})] \\ / [\text{平均粒径} (\mu\text{m})] \times 100$$

で得られる C V 値 (変動係数) を 10 % 以下とすることができる

5 (3) ほとんど完全な真球にすることができるため、基板上に形成された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいは I T O 導電膜等の電気素子などを傷つけるおそれがないなどの利点を有している。

また、最近では、粒子にある程度の軟らかさを持たせて液晶セル内の粒子の固着性を改善させた、アルキルトリアルコキシラン (メチルトリアルコキシラン) のような非加水分解性のアルキル基 (メチル基) を有するシリコンアルコキシドを加水分解、縮合して得られたポリオルガノシロキサン (ポリメチルシルセスキオキサン) 粒子も液晶表示装置のスペーサとして用いられている。

15 このようなポリメチルシルセスキオキサン粒子の製造方法として、メチルトリアルコキシランやその部分加水分解縮合物と、アンモニアやアミンを含む水溶液または水と有機溶剤との混合溶剤溶液とを、実質上混合することなく、2 層状態を保持しながら反応させる方法が提案されている (特公平 4-70335 号公報参照)。

20 しかしながら、この方法においては、生成するポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径は、仕込み時の下層中のアンモニアやアミンの濃度によって制御されるが、核粒子の生成が不確定なため、発生粒子核数にバラツキが生じやすく、同一反応条件で反応を行っても、最終的に得られる粒子の径が目的とする粒径とならない。例えば、平均粒径が 5 μm の粒子を得る目的で、同一条件で 10 回製造を行った場合、目的の粒径に対して 40 % 程度 (約 $\pm 2.0 \mu\text{m}$) のバラツキが生じる。

一方、粒径分布が单分散であって、所望の粒径のものが得られるポリオルガノシロキサン粒子の製造方法が提案されている。(特開 2000-80598 号公報参照)。

この方法は、メチルトリアルコキシランを加水分解、縮合させてポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させた後、このシード粒子を成長させて、より大粒径のポリオルガノシロキサン粒子を製造するものであり、その際、ある特定の算出式を用いて、シード粒子の5 平均粒径と粒子成長溶液の濃度などから、目的最終粒径に応じて決定されるシード粒子液の希釀倍率を導出し、かかる希釀倍率によりシード粒子液を希釀して、これを粒子成長用液に添加することにより、目的とする粒径に応じたポリオルガノシロキサン粒子を製造することを特徴とするものである。

しかし、この方法においては、製造バッチ毎に希釀倍率を算出し、希釀操作を行う必要がある。また、最近の液晶表示装置の仕様の変更により求められるようになつた、 $10\text{ }\mu\text{m}$ を超える大粒径のポリオルガノシロキサン粒子を製造することは困難である。さらに、粒径が $4\sim10\text{ }\mu\text{m}$ 程度で粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子は得られるものの、粒径の制御は μm オーダーで行われ、 nm オーダーレベルまで粒径を揃えようとする場合には、粒径の制御が困難である。
15

このように、得られる粒子が大粒径であつて、粒径分布が単分散であるポリオルガノシロキサン粒子の製造方法や、大粒径のポリオルガノシロキサン粒子を nm オーダーレベルまで粒径を揃えて製造する方法に20 ついては、これまでほとんど報告されていなかつた。

一方、ポリメチルシリセスキオキサン粉末を、その分子内に有する有機基（メチル基）が分解する温度（ $500\sim1300^\circ\text{C}$ ）にて焼成することにより、真球状シリカ粒子を製造する方法が開示されている（特公平5-13089号公報参照）。しかしながら、この方法においては、
25 ポリメチルシロキサン粒子を焼成してシリカ化する際、粒径の収縮が著しく、目的とするシリカ粒子の最終粒径を精度よく得るのが困難であるなどの問題があつた。したがつて、この方法で得られるシリカ粒子は、特に高い粒径精度〔低CV値、低い粒径のブレ（目的粒子の粒径-得られた粒子の粒径）〕が要求される液晶表示装置のスペーサなどの用途に

は不適であった。また、焼成時に有機基の分解、脱離が急激に起こり、粒子の破壊強度が低下したり、粒子が割れる場合があるなどの問題があった。

5 発明の開示

本発明は、このような事情のもとで、液晶表示装置用スペーサや標準粒子などとして好適な粒径範囲（1～30μm程度）を満たし、かつ粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を、簡便な操作によって短時間で収率よく製造する方法を提供することを第1の目的とする。

10 また、本発明は、ポリオルガノシロキサン粒子を焼成して、高い粒径精度〔低CV値、低い粒径のブレ（目的粒子の粒径－得られた粒子の粒径）〕のシリカ粒子を、簡便な操作で短時間に製造する工業的に有利な方法を提供することを第2の目的とする。

本発明者等は、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、非
15 加水分解性基と加水分解性のアルコキシル基がケイ素原子に結合した
ケイ素化合物を触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキ
サン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る
工程、および該シード粒子含有溶液に前記ケイ素化合物またはその加水
分解物を含む粒径成長用水性溶液を添加して、前記シード粒子の成長を
20 行う工程を経てポリオルガノシロキサン粒子を製造するに際し、

(i) 前記シード粒子含有溶液を得る工程において、ケイ素化合物を水
性媒体に溶解するに際し、該水性媒体に対し、0.7～6.5質量pp
mの塩基性触媒を添加して、予備的に加水分解、縮合させたのち、これ
に、ポリオルガノシロキサンからなるシード粒子の形成に必要な量の塩
25 基性触媒を添加し、該シード粒子を形成させることにより、または

(ii) 前記シード粒子成長工程において、連続的あるいは一定時間お
きに粒径を測定し、目的粒径に達した時点で反応を停止させることによ
り、または

(iii) 前記シード粒子成長工程において、アニオン性界面活性剤を、

粒径成長用水性溶液中のその濃度が特定の関係式を満たすように、上記粒径成長用水性溶液に存在させることにより、
第1の目的を達成し得ることを見出した。

また、本発明者は、ポリオルガノシロキサン粒子を加熱処理して、シリカ粒子を製造する際に、特定の温度で予備焼成したのち、ポリオルガノシロキサンの有機基の分解温度以上の温度で本焼成することにより、加熱処理時に認められる粒子の破壊強度の低下や粒子の割れが解消し、
第2の目的を達成し得ることを見出した。

すなわち、本発明は、

10 (1) 一般式 (I)



(式中、 R^1 は非加水分解性基であって、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、
(メタ) アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数 1 ~
20 のアルキル基、炭素数 2 ~ 20 のアルケニル基、炭素数 6 ~ 20 の
15 アリール基または炭素数 7 ~ 20 のアラルキル基、 R^2 は炭素数 1 ~ 6
のアルキル基、 n は 1 ~ 3 の整数を示し、 R^1 が複数ある場合、各 R^1 は
たがいに同一であっても異なっていてもよく、 OR^2 が複数ある場合、
各 OR^2 はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)

で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程 (A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式 (I)
20 で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程 (B) を含み、
シード粒子含有溶液を得る工程 (A) において、前記ケイ素化合物を水
25 性媒体に溶解するに際し、該水性媒体に対し、0.7 ~ 6.5 質量 ppm
の塩基性触媒を添加して、予備的に加水分解、縮合させたのち、これに、
ポリオルガノシロキサンからなるシード粒子の形成に必要な量の塩基性触媒を添加し、該シード粒子を形成させることを特徴とするポリオル
ガノシロキサン粒子の製造方法、

(2) 塩基性触媒がアンモニアである上記(1)に記載の方法、
 (3) 一般式(I)で表されるケイ素化合物がメチルトリメトキシシランまたはビニルトリメトキシシランである上記(1)または(2)に記載の方法、
 5 (4) 製造されたポリオルガノシロキサン粒子の平均粒子径が $10\text{ }\mu\text{m}$ を超える、かつ粒度分布の変動係数(CV値)が5%以下である上記(1)ないし(3)のいずれか1項に記載の方法、
 (5) 一般式(I)

$$\text{R}^1_n \text{Si}(\text{OR}^2)_{4-n} \cdots (\text{I})$$

10 (式中、 R^1 は非加水分解性基であって、炭素数1~20のアルキル基、(メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数6~20のアリール基または炭素数7~20のアラルキル基、 R^2 は炭素数1~6のアルキル基、 n は1~3の整数を示し、 R^1 が複数ある場合、各 R^1 はたがいに同一であっても異なっていてもよく、 OR^2 が複数ある場合、各 OR^2 はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)
 15 で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程(A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式(I)
 20 で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程(B)を含み、
 シード粒子成長工程(B)において、連続的あるいは一定時間おきに粒径を測定し、目的粒径に達した時点で反応を停止させることを特徴とするポリオルガノシロキサン粒子の製造方法、
 25 (6) 連続的あるいは一定時間おきに行われる粒径の測定が、反応溶液の一部を採取し、これと保護コロイド形成剤を接触させて反応溶液中の粒子に保護コロイドを形成させた後、コールター法で行われる上記(5)に記載の方法、
 (7) ポリオルガノシロキサン粒子がポリメチルシルセスキオキサン粒

子である上記（5）または（6）に記載の方法、

（8）粒径が $10\text{ }\mu\text{m}$ を超えるポリオルガノシロキサン粒子を得ようとする場合、ケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液の添加速度が、シード粒子含有溶液の体積 1 ミリリットル に対して $0.$

5 0.1 ミリリットル/分 以下である上記（5）～（7）のいずれか1項に記載の方法、

（9）最終的に得られたポリオルガノシロキサン粒子の粒径が $1\sim 30\text{ }\mu\text{m}$ 、変動係数が 3% 以下である上記（5）～（8）のいずれか1項に記載の方法、

10 (10) 一般式 (I)



(式中、 R^1 は非加水分解性基であって、炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、(メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数 $1\sim 20$ のアルキル基、炭素数 $2\sim 20$ のアルケニル基、炭素数 $6\sim 20$ のアリール基または炭素数 $7\sim 20$ のアラルキル基、 R^2 は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、 n は $1\sim 3$ の整数を示し、 R^1 が複数ある場合、各 R^1 はたがいに同一であっても異なっていてもよく、 OR^2 が複数ある場合、各 OR^2 はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)

で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオ

20 ルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程(A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式(I)で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程(B)を含み、

シード粒子成長工程(B)において、アニオン性界面活性剤を関係式
25 (II)

$$Y = \alpha \times (a \times X) / (A \times R) \cdots (II)$$

ただし、 a はケイ素化合物が加水分解、縮合した後の生成物の分子量をケイ素化合物の分子量で割った理論値

Y は粒径成長用水性溶液中におけるアニオン性界面活性剤の濃度(質

量%)

Xはシード粒子合成に使用する原料の質量(g)

Aはシード粒子成長工程(B)に使用する溶液の総質量(g)

Rはシード粒子の平均粒径(μm)

5 αは係数で、4.0 < α ≤ 7.5

を満たす濃度でシード粒子含有溶液に添加して、シード粒子を成長させることを特徴とするポリオルガノシロキサン粒子の製造方法、

(11) アニオン性界面活性剤が、HLB値1.5~4.0のものである上記(10)に記載の方法、

10 (12) アニオン性界面活性剤が高級アルコール硫酸エステル塩である上記(11)に記載の方法、

(13) 高級アルコール硫酸エステル塩がドデシル硫酸ナトリウムである上記(12)に記載の方法、

15 (14) シード粒子形成工程(A)において、別途作製したポリオルガノシロキサン粒子含有溶液をケイ素化合物を含む反応系に添加し、ポリオルガノシロキサン粒子の存在下でケイ素化合物を加水分解、縮合させてシード粒子を形成させる上記(10)ないし(13)のいずれか1項に記載の方法、および

20 (15) ポリオルガノシロキサン粒子が、平均粒子径10μmを超えるものである上記(10)ないし(14)のいずれか1項に記載の方法、

(16) 上記(1)ないし(15)のいずれか1項に記載の方法で得られたポリオルガノシロキサン粒子を、その中に含まれる有機基の分解温度より150°C低い温度以上で、かつ当該有機基の分解温度未満の範囲において予備焼成した後、当該有機基の分解温度以上の温度で焼成処理

25 することを特徴とするシリカ粒子の製造方法

を提供するものである。

本発明ポリオルガノシロキサン粒子の製造方法によれば、比較的大きな粒径範囲(1~30μm程度)を満たし、かつ粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を、その都度、所望の粒径のものが得られる

ように、短時間で収率よく、シード粒子成長用液の希釀操作等を必要としない簡便な操作により、製造することができる。この方法で得られたポリオルガノシロキサン粒子は、液晶表示装置用スペーサや標準粒子などとして好適である。

5 また、本発明のシリカ粒子の製造方法によれば、上記方法で得られたポリオルガノシロキサン粒子を、特定の条件で焼成処理することにより、液晶表示装置用スペーサや標準粒子などとして好適な粒径を有し、かつ粒径分布が高度に単分散なシリカ粒子を、簡便な操作で短時間に製造することができる。

10

図面の簡単な説明

図 1 は、実施例 1 におけるシード粒子形成用液中の微小粒子の粒径を、コールターカウンターにより測定して得られた粒径分布チャートである。

15 図 2 は、実施例 1 におけるシード粒子液中のシード粒子の粒径を、コールターカウンターにより測定して得られた粒径分布チャートである。

図 3 は、実施例 1 における粒子成長液中のポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径を、コールターカウンターにより測定して得られた粒径分布チャートである。

20

発明を実施するための最良の形態

本発明のポリオルガノシロキサンの製造方法は、請求項 1 に記載された第 1 の態様、請求項 5 に記載された第 2 の態様および請求項 10 に記載された第 3 の態様を含み、3 つの態様は、シード粒子含有溶液調製工程 (A) およびシード粒子成長工程 (B) を含むという構成要件を共通にする。そして、この構成要件に加えて、本発明の第 1 の態様は、シード粒子含有溶液調整工程 (A) において、ケイ素化合物を水性媒体に溶解するに際し、該水性媒体に対し、0.7 ~ 6.5 質量 ppm の塩基性触媒を添加して、予備的に加水分解、縮合させたのち、これに、ポリオ

ルガノシロキサンからなるシード粒子の形成に必要な量の塩基性触媒を添加し、該シード粒子を形成させることを構成要件とする。また、本発明の第2の態様は、シード粒子成長工程（B）において、連続的あるいは一定時間おきに粒径を測定し、目的粒径に達した時点で反応を停止させることを構成要件とする。さらに、本発明の第3の態様は、シード粒子成長工程（B）において、アニオン性界面活性剤を特定の関係式を満たす濃度で含む粒径成長用水性溶液をシード粒子含有溶液に添加して、シード粒子を成長させることを構成要件とする。

5 先ず、本発明の第1～第3の態様において、共通する構成要件である
10 工程（A）および（B）について順次説明する。

工程（A）

工程（A）においては、原料として、一般式（I）



で表されるケイ素化合物が用いられる。

15 上記一般式（I）において、 R^1 は炭素数1～20のアルキル基、（メタ）アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20のアリール基又は炭素数7～20のアラルキル基を示す。ここで、炭素数1～20のアルキル基としては、炭素数1～10のものが好ましく、またこのアルキル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。このアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソブロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。（メタ）アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基としては、上記置換基を有する炭素数1～10のアルキル基が好ましく、またこのアルキル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。この置換基を有するアルキル基の例としては、 γ -アクリロイルオキシプロピル基、 γ -メタクリロイルオキシプロピル基、 γ -グリシドキシプロピル基、

3, 4-エポキシシクロヘキシル基などが挙げられる。炭素数2～20のアルケニル基としては、炭素数2～10のアルケニル基が好ましく、また、このアルケニル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。このアルケニル基の例としては、ビニル基、アリル基、ブテニル基、5ヘキセニル基、オクテニル基などが挙げられる。炭素数6～20のアリール基としては、炭素数6～10のものが好ましく、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基などが挙げられる。炭素数7～20のアラルキル基としては、炭素数7～10のものが好ましく、例えばベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピル基、ナフチルメチル基など10が挙げられる。

一方、R²は炭素数1～6のアルキル基であって、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよく、その例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロ15ペンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。

nは1～3の整数であり、R¹が複数ある場合、各R¹はたがいに同一であってもよいし、異なっていてもよく、またOR²が複数ある場合、各OR²はたがいに同一であってもよいし、異なっていてもよい。

上記一般式(I)で表されるケイ素化合物の例としては、メチルトリ20メトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 α -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 α -アクリロイルオキシプロ25ピルトリメトキシシラン、 α -メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、ジビニルジメトキシシラン、ジビニルジエトキシシラン、トリビニルメトキシシラン、トリビニルエトキシシランなどが挙げられる。

これらの中で、ポリオルガノシロキサン粒子として得られた後、加熱処理によってシリカ化する工程において、その粒径収縮が少ないと有機分除去によるシリカ化の際の効率などから、有機成分の少ないものが好ましく、メチルトリメトキシシランおよびビニルトリメトキシシランが好ましく、特にメチルトリメトキシシランが好適である。

本発明においては、原料として、上記一般式（I）で表されるケイ素化合物を1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

工程（A）は、下記の操作（1）および（2）を含む。

（1）シード粒子形成用液の調製

（2）シード粒子の形成

以下、上記操作（1）および（2）について詳述する。

（1）シード粒子形成用液の調製

本発明のポリオルガノシロキサン粒子の製造方法においては、シード粒子の形成および粒径の成長を、それぞれ均一系で実施するために、このシード粒子形成用液の調製に用いられるケイ素化合物としては、上記一般式（I）で表される化合物の中から、比重に関係なく、適宜選択して使用することができる。シード粒子の形成および粒径の成長を、それぞれ2層法で実施する場合には、ケイ素化合物として、水性媒体よりも比重の軽いものを用いることが必要であるので、原料の種類が制限されるのを免れないが、本発明においては、このような比重の制約がないので、原料の選択自由度が大きい。

上記ケイ素化合物としては、水性媒体に対して混和性を有するものであれば特に制限はなく、上述の各種ケイ素化合物が用いられるが、なかでも水性媒体に溶解しやすいもの、例えばメトキシ基を有するケイ素化合物が好適である。また、焼成によってシリカ粒子を得る場合には、前述のようにケイ素含有率の高いメチルトリメトキシシランが最も好ましい。

また、水性媒体としては、水または水と水混和性有機溶剤との混合物を用いることができる。ここで、使用する水は陽イオンが少いほど好ま

しく、伝導度 $0.5 \times 10^{-4} \text{ S/cm}$ 以下であることが好ましい。

水混和性有機溶剤の例としては、メタノール、エタノール、プロパン
1 一₁、ブタノールなどの低級アルコール類、アセトンなどのケトン類など
が挙げられる。これらは単独で水と混合してもよいし、2種以上を組
み合わせて水と混合してもよい。

このシード粒子形成用液の調製は、上記水性媒体中に、上記ケイ素化
合物を添加し、通常 $0 \sim 50^\circ\text{C}$ 程度の温度で攪拌して均一な水性溶液と
することにより行われる。この際、ケイ素化合物の濃度は、20質量%以
下が好ましい。この濃度が20質量%を超えると、粒径分布の変動係数
10 が大きくなり、濃度があまり低すぎると容積効率などが悪くなり、工業
的に不利となる。より好ましい濃度は、5～15質量%の範囲である。

シード粒子形成用液調製時の攪拌速度については、該シード粒子形成
用液の調製容器の大きさおよび羽根の大きさなどにより攪拌効果が異
なるため、一概に決めることはできない。

15 さらに、ケイ素化合物を溶解させるに要する時間は、溶解時の温度な
どに左右されるため、特に限定されないが、溶解時間が長すぎると本發
明の効果が十分に發揮されない。

本発明の第1の態様は、シード粒子含有溶液調製工程（A）に特徴が
ある。すなわち、上記シード粒子形成用液の調製において、ケイ素化
20 物を予備的に加水分解、縮合させるため、上記水性媒体に対し、0.7
～6.5質量ppmの塩基性触媒を添加することを必須の構成要件とし、
これにより、後記（2）のシード粒子の形成操作において、従来の方法
に比べて粒径の大きなシード粒子を形成することができ、その結果、こ
のシード粒子を成長させることにより、平均粒径が例えば $10 \mu\text{m}$ より
25 大きく、かつ粒径分布が单分散のポリオルガノシロキサン粒子を効率よ
く製造することができるという効果が得られる。

なお、得られたシード粒子が例えば $10 \mu\text{m}$ 以上の大粒径を有し、得
ようとするポリオルガノシロキサン粒子の粒径が同程度である場合に
は、シード粒子含有溶液調製工程（A）と、後記するシード粒子成長工

程（B）とが同時に行われたこととして、その後にシード粒子の成長操作を行う必要がない。

上記塩基性触媒は、後記する（2）シード粒子の形成において用いるものと同様である。

5 上記塩基性触媒の添加量を、使用する水性媒体に対し、0.7～6.5質量ppmの範囲に限定する理由は、上記範囲を逸脱すると、シード粒子の形成において、大粒径のものを得ることができず、本発明の効果が発揮されないからである。好ましい添加量は塩基性触媒の種類、水性媒体の種類、ケイ素化合物の種類や濃度、シード粒子形成用液の調製温度などによって左右されるが、通常1.0～5.0質量ppmの範囲で選定される。

（2）シード粒子の形成

15 上記の操作（1）で調製したシード粒子形成用液を攪拌しながら、触媒として、塩基性触媒、好ましくはアンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液を一気に添加し、ケイ素化合物を加水分解、縮合させて、シード粒子を形成させ、シード粒子含有溶液とする。

アンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液は、ゆっくり添加すると系が均一となり新たな核粒子が大量に発生してしまい粒径が小さくなるため、一気に添加することが好ましい。

20 アンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液添加時の攪拌速度は、反応槽の大きさと羽根の形状・大きさにより適宜選択することができる。ここで、アミンとしては、例えばモノメチルアミン、ジメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミンなどを好ましく挙げることができる。このアンモニアやアミンは単独で用いてもよいし、25 2種以上を組み合わせて用いてもよいが、毒性が少なく、除去が容易で、かつ安価なことから、アンモニアが好適である。

また、アンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液としては、水または水と水混和性有機溶剤との混合溶剤にアンモニアおよび／またはアミンを溶解した溶液が挙げられる。ここで、使用する水は陽イオンが

少なければ良く、伝導度 $0.5 \times 10^{-4} \text{ S/cm}$ 以下であることが好ましい。また、水混和性有機溶剤の例としては、上記(1)のシード粒子形成用液の調製についての説明において例示したものと同じものを挙げることができる。

5 このアンモニアおよび/またはアミン含有水性溶液の添加量は、シード粒子形成後のシード粒子液の pH が、好ましくは 8.2 ~ 11.0 の範囲になるように選定するのが有利である。

10 反応温度は、原料のケイ素化合物の種類などにより左右されるが、一般的には 0 ~ 50°C の範囲で選ばれる。0°C より低いと使用する水性媒体が凍結してしまいその機能を発揮しなくなり、50°C 以上で合成すると使用するアルコキシドが揮発してしまって収率が低下する。比較的大きな粒径 (粒径 10 μm 超 ~ 30 μm 程度) のポリオルガノシロキサン粒子を製造するときは 5°C ~ 30°C、小さな粒径 (1 μm ~ 10 μm) のポリオルガノシロキサン粒子を製造するときは 35°C ~ 40°C で製造することが好ましい。

15 シード粒子の形成時間は通常 1 時間以内で十分である。シード粒子を 2 層法で形成する場合には、4 ~ 10 時間程度を要するが、本発明のように均一系による方法を採用すると、はるかに短時間でシード粒子を形成させることができる。

20 シード粒子形成後、得られたシード粒子の粒径が測定される。粒径の測定方法は特に限定されないが、コールター法や、光学顕微鏡ビデオミクロメーターにより測定することができ、測定操作の簡便性、迅速性からコールター法で測定することが好ましい。

25 ここでコールター法とは、溶液中に分散している粒子の大きさを電気的に測定する装置を用いた測定方法をいう。本装置は、測定粒子を懸濁・分散させた電解液中に微細孔を有するチューブ (アパチャーチューブ) を設置したもので、アパチャーチューブの内側と外側に電極を置き、電解液を介して両電極間に電流が流れるように構成される。電解液中に分散した測定粒子が吸引され、アパチャーチューブの微細孔を通過

する際、粒子体積に相当する電解液が置換されて両電極間の電気抵抗に変化が生じ、かかる抵抗変化を電圧パルスに変換し、これを増幅・検出して粒径測定を行うものである。

粒径測定の際、粒子の懸濁に使用される保護コロイド形成剤としては、種々のものが使用できるが、例えばアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアルキルアリールスルホン酸塩、ドデシルスルホン酸ナトリウムなどのアルキルスルホン酸塩、ラウリン酸ナトリウムなどの脂肪酸石鹼などのアニオン性界面活性剤、ポリメタクリル酸、アルギン酸、ポリマレイン酸、ポリビニルアルコールなどの高分子界面活性剤などを挙げることができ、ポリビニルアルコールを用いることが好ましい。これらの保護コロイド形成剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合せて用いてもよい。

本発明は、目的最終粒径よりも粒径の小さなシード粒子を形成し、次いで粒径成長用水性溶液により目的粒径まで成長させる方法に関する。一方、得られたシード粒子の粒径が目的最終粒径に比べて小さ過ぎる場合等は、適宜公知の方法、例えば特開2002-80598号公報記載の方法により、シード粒子を適当な粒径（目的最終粒径よりは小さい）まで成長させた後、下記粒径成長用水性溶液によるシード粒子成長工程に付すことができる。

シード粒子を形成するための操作（2）においてシード粒子を形成する際に、シード粒子形成用液および触媒と共に、予め作製したポリオルガノシロキサン粒子を含有する溶液（以下、添加用粒子含有液という）を添加することもできる。添加用粒子含有液の調製は、以下のようにして行われる。

25 (添加用粒子含有液の調製)

所定のケイ素化合物を水性媒体に加え、通常0～50°C程度の温度で攪拌して、実質上均一な水性溶液としたのち、塩基性触媒を加え、該ケイ素化合物の加水分解、縮合を行い、粒子を形成させ、添加用粒子含有液を調製する。

上記水性媒体としては、水または水と水混和性有機溶剤との混合物を用いることができる。ここで、水混和性有機溶剤の例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコール類、アセトンなどのケトン類などが挙げられる。これらは単独で水と混合してもよいし、
5 2種以上を組み合わせて水と混合してもよい。

また、塩基性触媒として、好ましくはアンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液を一気に添加し、ケイ素化合物を加水分解、縮合させて、添加用粒子を形成させ、添加用粒子含有液とする。

ここで、アミンとしては、例えばモノメチルアミン、ジメチルアミン、
10 モノエチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミンなどを好ましく挙げることができる。このアンモニアやアミンは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよいが、毒性が少なく、除去が容易で、かつ安価なことから、アンモニアが好適である。

また、アンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液としては、水または水と水混和性有機溶剤との混合溶剤にアンモニアおよび／またはアミンを溶解した溶液が挙げられる。ここで、水混和性有機溶剤の例としては、上記で例示したものと同じものを挙げることができる。

水性溶液中のケイ素化合物の濃度は、20質量%以下が好ましく、特に5～15質量%の範囲が、生成する粒子の粒径および容積効率などの点から好適である。また、アンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液の添加量は、粒子形成後の添加用粒子含有液のpHが、好ましくは8.0～10.5の範囲になるように選定するのが有利である。反応時間は、通常1時間以内で十分である。

このようにして形成された添加用粒子の平均粒子径は、一般に3.0
25 ～6.0μm程度である。

なお、添加用粒子の製造に用いられるケイ素化合物の種類、水性媒体の種類、塩基性触媒の種類などは、シード粒子の製造に用いられるものと同一であってもよいし、異なっていてもよいが、作業性や得られる粒子の性状などの点から、同一であることが好ましい。

添加用粒子含有液を用いると、用いない場合よりも大粒径のシード粒子が得られるが、その理由は、明確ではないが、添加用粒子の存在下では、非存在下の場合よりも、形成されるシード粒子の発生個数が少なくなるためであると推察される。添加用粒子の存在下のシード粒子形成における溶液中では、シード粒子のもとになる核が発生する反応と、添加用粒子が成長する反応が同時に起こっており、そのことが前記理由の要因となっているのではないかと思われる。

添加用粒子含有液を併用した場合には、シード粒子形成終了後において、加えられた添加用粒子含有液中の粒子数に対する新たに生成した粒子数の比（以下、個数比と称す。）が、2以上であることが好ましい。本発明においては、このシード粒子の形成で新たに生成した粒子を成長させたものが、目的のポリオルガノシロキサン粒子となることから、上記個数比が2未満ではシード粒子中の添加粒子の存在が無視できなくなり、最終的に得られるポリオルガノシロキサン粒子の歩留まりが低下し、工業的に不利となる場合がある。また、該個数比があまり大きすぎると新たに生成する粒子の粒径を大きくする効果が十分に発揮されず、添加用粒子含有液を加える目的が達せられにくい。より好ましい個数比は4～50であり、特に20～45の範囲が好ましい。

本発明においては、上記の個数比を求めるために、シード粒子形成後、シード粒子液の一部を採取し、保護コロイド形成剤と接触させて、シード粒子に保護コロイドを形成させたのち、例えばコールター法にて、該シード粒子の粒子径を測定し、添加用粒子が成長した粒子の平均粒子径および新たに生成した粒子の平均粒子径を求ることにより、上記の個数比を算出することができる。

上記のように、保護コロイドを形成させることにより、コールター法における計測時の粒子径が収縮することなく、安定した計測が可能となる。

ここで、保護コロイド形成剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどのアルキルアリールスルホン酸塩、ドデシルスル

ホン酸ナトリウムなどのアルキルスルホン酸塩、ラウリン酸ナトリウムなどの脂肪酸石鹼などのアニオン性界面活性剤、ポリメタクリル酸、アルギン酸、ポリマレイン酸、ポリビニルアルコールなどの高分子界面活性剤などを挙げることができる。これらの中で、特にポリビニルアルコールが好適である。これらの保護コロイド形成剤は1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

工程 (B)

本発明の第1～第3の態様において、工程(B)は、工程(A)で得られたシード粒子含有溶液に、上記一般式(I)で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液を添加して、上記シード粒子の成長を行う工程であり、下記の操作(3)および(4)を含む。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応停止

以下、上記操作(3)および(4)について詳述する。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

粒径成長用水性溶液としては、上記一般式(I)で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む水性溶液が用いられる。

一般式(I)で表されるケイ素化合物としては、前述した種々のケイ素化合物が挙げられる。また、一般式(I)で表されるケイ素化合物の加水分解物とは、一般式(I)で表される1～3個のアルコキシル基を有するケイ素化合物を部分的にまたは完全に加水分解したものである。

ケイ素化合物またはその加水分解物を含む水性溶液の調製は、上記工程(A)中の操作(1)のシード粒子形成用液の調製に用いた水または水と水混和性有機溶剤との混合物や上記操作(2)のシード粒子の形成に用いたアンモニアおよび／またはアミン含有水性溶液を媒体として用いて行われる。

この粒径成長用水性溶液の調製において、ケイ素化合物の種類、その濃度及び水性媒体の種類などは、上記シード粒子形成用液のそれらと同

一のものを用いてもよいし、異なっていてもよいが、作業性や得られる粒子の性状などの点から、同一であるものが好ましい。

ケイ素化合物の濃度は、20質量%以下が好ましく、特に5～15質量%の範囲が、成長粒子の粒径および容積効率などの点から好適である。

5 上記粒径成長用水性溶液として用いられる一般式（I）で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む水性溶液は、均一溶液の状態で、以下の操作（4）における反応に供せられる。

10 本発明の第3の態様においては、上記粒径成長用水性溶液は、さらにアニオン性界面活性剤を必須成分として含む。粒径成長用水性溶液におけるアニオン性界面活性剤の濃度などは後述する。

（4）目的粒径への成長およびその後の反応停止

15 この操作（4）は、工程（A）中の上記操作（2）で得られたシード粒子含有溶液に、上記操作（3）で得られた粒径成長用水性溶液を攪拌しながら、添加し、粒径を目的粒径まで成長させるか、または、上記操作（3）で得られた粒径成長用水性溶液を攪拌しながら、これに、工程

（A）中の上記操作（2）で得られたシード粒子含有溶液を添加し、粒径を目的粒径まで成長させるものである。この際の反応温度は、原料のケイ素化合物の種類などに左右されるが、一般的には0～50°Cの範囲で選ばれる。

20 粒径成長用水性溶液をシード粒子含有溶液に添加する場合、粒径成長用水性溶液は連続的に添加することができ、この場合、粒径成長用水性溶液の添加速度は特に制限されないが、シード粒子含有溶液の体積1ミリリットルに対して0.02ミリリットル/分以下が好ましく、より好ましくは0.01ミリリットル/分以下である。大粒径（10μm超）のポリオルガノシロキサン粒子を得る場合は、上記添加速度が、シード粒子含有溶液の体積1ミリリットルに対して0.01ミリリットル/分を超えると、全体の粒子群内に微小粒子が発生するとともに、各粒子内部に屈折率の異なる部分を有する粒子が観察される場合があるので、シード粒子含有溶液の体積1ミリリットルに対して0.01ミリリットル

／分以下とすることが好ましい。なお、上記屈折率の異なる部分を有する粒子は気泡を有していると考えられるため、以下気泡粒子と呼称する。

ここで本発明の第2の態様および第3の態様それそれにおいて固有の、粒径成長工程（B）実施上の構成要件について順次説明する。

5 本発明の第2の態様においては、工程（B）の操作（4）において所望の最終粒径に達するまで、粒径の測定を連続的または一定時間おきに行うことを必須要件とする。

ここで粒径の測定方法は特に限定されず種々の方法が用いられる。反応溶液の一部を採取し、これと保護コロイド形成剤を接触させて反応溶液10中の粒子に保護コロイドを形成させた後、コールター法や光学顕微鏡ビデオミクロメーターを用いて測定するのが好ましく、コールター法で測定するのが特に好ましい。コールター法による粒径の測定については、工程（A）中の上記操作（2）のシード粒子の形成で詳説した通りである。

15 上記粒径成長用水性溶液の添加後、ポリオルガノシロキサン粒子が目的とする粒径に到達したことが確認されたとき、粒径成長用水性溶液の添加を停止する。

一方、本発明の第3の態様においては、工程（B）の操作（4）において、シード粒子を目的粒径へ成長させる際、アニオン性界面活性剤を含む粒径成長用水性溶液をシード粒子含有溶液に添加することを必須要件とする。

上記アニオン性界面活性剤の添加により、粒径成長時において、粒子表面の加水分解縮合が進むに伴い、表面特性が非加水分解性基に基づく疎水性を示すことによる凝集を防ぐことができる。このアニオン性界面活性剤としては、HLB値（親水性と親油性のバランスを表す指標）が25 15～42の範囲にあるものが好ましく、15～40の範囲にあるものがより好ましい。さらに、アニオン性界面活性剤は、高級アルコール硫酸エステル塩（長鎖アルキル硫酸塩）が好ましく、特にドデシル硫酸ナトリウムが好適である。

本発明の第3の態様においては、上記アニオン性界面活性剤は、粒径成長用水性溶液中の濃度が、関係式(II)

$$Y = \alpha \times (a \times X) / (A \times R) \quad \dots \text{ (II)}$$

ただし、aはケイ素化合物が加水分解、縮合した後の生成物の分子量

5 をケイ素化合物の分子量で割った理論値

Yは粒径成長用水性溶液中におけるアニオン性界面活性剤の濃度(質量%)

Xはシード粒子合成に使用する原料の質量(g)

Aはシード粒子成長工程(B)に使用する溶液の総質量(g)

10 Rはシード粒子の平均粒径(μm)

αは係数で、 $4.0 < \alpha \leq 7.5$

を満たすように、粒径成長用水性溶液に含有されている。なお、上記関係式(II)において、Aで示されるシード粒子成長工程(B)に使用する溶液の総質量とは、シード粒子成長工程(B)に用いるケイ素化合物

15 の質量とイオン交換水などの水性溶媒の質量の和のことである。

粒径成長用水性溶液中のアニオン性界面活性剤の濃度Yが、関係式(II)で算出される値より低い場合、粒子表面の非加水分解性基に基づく疎水性により、粒子の凝集が生じ、本発明の目的が達せられない。一方、Yが、関係式(II)で算出される値よりも高い場合、粒子の成長速度が著しく低下し、目的とする粒径に達した段階で、例えばアンモニアを添加すると、内部に気泡を有する粒子が生成し、得られる粒子の圧縮強度が低下する。上記関係式(II)におけるαの好ましい値は4.0より大きく7.0以下であり、特に20~60の範囲が好ましい。

本発明の第3の態様においては、上記のアニオン性界面活性剤を含む粒径成長用液を攪拌しながら、これに、前述のシード粒子形成液を加え、粒子径を成長させるのがよい。また、この粒径の成長は、必要に応じ、多段階で行うことができる。多段階で粒径の成長を行う場合には、予め調製した界面活性剤を含まない粒径成長用水性溶液を攪拌しながら、これに、前段階の粒径の成長操作で得られた粒子成長液をシード粒子液と

して加え、粒径を成長させるのがよい。

本発明の第1～第3の態様のいずれにおいても、粒径の成長状態を確認するために、シード粒子含有溶液の添加後から、光学顕微鏡ビデオミクロメーターで、連続的あるいは一定時間おきに粒径を測定し、該粒子径の変化が実質上なくなった時点で、粒径の成長が終了したと判断することができ、その後の反応を停止することができる。

本発明の第1～第3の態様のいずれにおいても、上記粒径成長は一般に3時間以内で十分である。2層法を採用して粒径を成長させる場合、通常6～10時間程度を要するが、本発明のように実質的に均一系で反応させることにより、はるかに短時間で粒径を成長させることができる。

2層法の場合、上層のケイ素化合物が、空気中の水分などによって自己縮合を起こして変質し、例えば飴状になって攪拌翼に巻き付いたりして、粒径の成長に使用されるケイ素化合物量が低下し、所望の粒径を有する粒子が得られない場合があるが、本発明の方法では、均一系で粒径を成長させるので、このような問題は生じない。

本発明の第1～第3の態様のいずれにおいても、ポリオルガノシロキサン粒子が目的とする粒径に到達したことが確認されたとき、塩基性触媒、例えば、アンモニアおよび/またはアミン含有水性溶液を添加して熟成を行う。この熟成は、原料のケイ素化合物の種類にもよるが、通常0～50°Cの範囲の温度において、6～24時間程度行われる。

この熟成操作終了後、常法に従い生成した粒子を十分に洗浄したのち、必要に応じ、その中に含まれる比率の高い粒径の粒子を分級して取り出し、乾燥処理を行う。なお、比率の低い粒径の粒子についても、CV値が格段悪化するわけではないため、場合によっては、分級して取り出し、使用することは可能である。分級処理方法としては特に制限はないが、粒径により沈降速度が異なるのを利用して分級を行う湿式分級法が好ましい。なお、ポリオルガノシロキサン粒子を最終的にシリカ粒子化する場合、上記の湿式分級は水を用いることが可能となるシリカ粒子化後に行なうことが、コストや環境の面から好ましい。乾燥処理は、通常10

0～200°Cの範囲の温度で行われる。本発明においては、この乾燥処理において、粒子の凝集が実質上生じることはない。

なお、変動係数（CV値）は下式により求められる。

$$CV\text{ 値} (\%) = (\text{粒径の標準偏差} / \text{平均粒径}) \times 100$$

5 また、本発明における平均粒径とCV値は、以下の方法で算出した。まずコールター法の測定結果から、予備的に、孤立した粒径分布ピーク幅を測定範囲として選択し、予備平均粒径値と σ （標準偏差）を算出する。そして、その予備平均粒径値から、 $\pm 3\sigma$ の範囲を選択し、改めて、その範囲内において、平均粒径とCV値を算出する。複数の孤立した粒10 径分布ピークが複数ある場合は、そのピーク毎に、算出を行う。

本発明の第1の態様において得られるポリオルガノシロキサン粒子は、平均粒子径が、通常10 μmより大きく、好ましくは12.5～25 μmである。また、粒度分布の変動係数（CV値）が、通常5%以下、好ましくは2.5%以下であって、真球状の单分散粒子である。本態様においては、従来の方法に比べ粒径の大きなシード粒子を形成することができ、その結果、このシード粒子を成長させることにより、あるいは場合により成長操作を行わなくても、大粒径でかつ粒径分布が单分散のポリオルガノシロキサン粒子を効率的に製造することが可能となる。

本発明の第2の態様において得られるポリオルガノシロキサン粒子20 は、平均粒径が、1～30 μm、好ましくは3～25 μm、更に好ましくは3～20 μmであり、また、粒度分布の変動係数（CV値）が、3%以下、好ましくは2.5%以下であって、真球状の单分散粒子である。本態様においては、粒径成長用水性溶液の添加に際しシード粒子形成用液の希釈率の算出や希釈操作を必要とせず、簡便な操作によりポリオルガノシロキサン粒子の製造が可能となる。更に、得られるポリオルガノシロキサン粒子の粒径がnmオーダーで制御可能となる。

また、本発明の第3の態様において得られるポリオルガノシロキサン粒子は、平均粒径が、通常10 μmより大きく、好ましくは12.5～25 μmである。また、粒度分布の変動係数（CV値）が、通常2.5%

以下であって、真球状の単分散粒子である。本態様においては、粒径成長用エキソマトリクスの添加に際しシード粒子形成用液の希釈率の算出や希釈操作を必要とせず、簡便な操作によりポリオルガノシロキサン粒子の製造が可能となる。

5 次に、本発明のシリカ粒子の製造方法について説明する。

この方法は、ポリオルガノシロキサン粒子を焼成処理して、その中に含まれる有機基を分解し、シリカ粒子を製造する方法であって、上記ポリオルガノシロキサン粒子として、前述の製法で得られたポリオルガノシロキサン粒子を用いる。

10 この方法においては、本発明の第1～第3の態様で得られたポリオルガノシロキサン粒子を、その中に含まれる有機基の分解温度より150°C低い温度以上で、かつ当該有機基の分解温度未満の範囲の温度において予備焼成処理したのち、当該有機基の分解温度以上の温度で焼成処理してシリカ粒子を製造する。

15 上記ポリオルガノシロキサン粒子に含まれる有機基の分解温度以上の温度に直ちに昇温して焼成すると、当該有機基の分解、脱離が急激に起こり、粒子の破壊強度が低下したり、場合によっては急激な収縮に耐えきれず、粒子が割れるなど、好ましくない事態を招来することがある。しかし、本発明のように、当該有機基の分解温度より150°C低い温度以上で、かつ当該有機基の分解温度未満の範囲の温度で予備焼成処理を行ってから、当該有機基の分解温度以上の温度で焼成処理することにより、上記の好ましくない事態を回避することができる。好ましくは、当該有機基の分解温度より100°C低い温度以上で、かつ当該有機基の分解温度未満の範囲の温度で予備焼成処理を行ってから、当該有機基の分解温度以上の温度で焼成処理する。

焼成時間の選定は、ポリオルガノシロキサン粒子を構成する有機基の種類に依存しており、熱分解しやすい有機基を有する場合、比較的低い温度で処理するのが望ましく、反対に熱分解しにくい有機基を有する場合には高温で処理するのが好ましい。いずれにしても、必要となる破壊

強度や弾性率に応じて最適な条件を選定すればよい。具体的には、ポリメチルシルセスキオキサン（PMSO）粒子の場合、250～350°Cの範囲の温度において3～50時間程度保持して予備焼成処理を行ったのち、500～1300°Cの範囲（好ましくは500～1000°Cの範囲）の温度において3～50時間程度保持して焼成処理し、有機基を完全に分解する。

上記焼成処理における雰囲気としては、有機基を酸化分解してシリカ化するために、酸素濃度が一定以上、例えば10容量%以上であることが好ましい。また、焼成装置については特に制限はなく、電気炉やロータリーキルンなど公知の焼成装置を用いることができる。

次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

実施例1（第1の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造）

（1）シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000gに、1モル／リットルアンモニア水0.8ミリリットル（NH₃：2.7ppm）、メチルトリメトキシシラン（以下、MTMSと略記する。）500gを添加して25°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、薄く白濁していた。これをシード粒子形成用液とした。このシード粒子形成用液における微小粒子の粒径分布をコールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」）にて測定した。この粒径分布チャートを図1に示す。

（2）シード粒子の形成

攪拌速度を30rpmに下げ、上記（1）で調製したシード粒子形成用液に1モル／リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加20分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、該シード粒子液におけるシード粒子の粒径分布をコールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」）にて測定した。この粒径分

布チャートを図 2 に示す。該シード粒子は、平均粒子径が 5. 477 μ m であり、CV 値が 2. 57 % であった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水 33, 000 g に、MTMS 4, 950 g を添加して、
5 30 °C にて 100 rpm で攪拌した。約 3 時間後に MTMS は完全に溶
解して均一溶液となり、これを粒径成長用水性溶液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

上記 (3) の粒径成長用水性溶液全量を 20 rpm で攪拌しながら、
これに上記 (2) で得られたシード粒子含有溶液 5, 528 g を添加し
10 た。

シード粒子含有溶液の添加から、10 分毎に光学顕微鏡ビデオミクロ
メーター (オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」) で粒
子径を測定した。添加から 30 分後と 35 分後は、いずれも平均粒子径
が約 14. 8 μ m であり、粒径成長が終了したと判断して、2. 5 質量 %
15 アンモニア水 1, 000 g を定量ポンプにて滴下して熟成を行った。

このようにして得られたポリメチルシリセスキオキサン (PMOS) 粒子の粒径分布をコールターカウンター (ベックマン・コールター社製「マルチサイザ-III」) にて測定した。この粒径分布チャートを図 3 に示す。該 PMOS 粒子の平均粒子径は 14. 73 μ m であり、CV 値が
20 1. 63 % であった。

(5) 微小粒子の分級および乾燥

得られた粒子は遠心分離機により固液分離し、その後メタノール中で
超音波を照射後、デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことによ
つて、微小粒子を除去した。残った粒子は風乾したのち、残留メタノー
ルを除去するために 150 °C にて乾燥させた。このようにして得られた
25 PMOS 粒子の収率は 70 % であった。

実施例 2 (シリカ粒子の製造)

実施例 1 で得られた PMOS 粒子を、空気流量 1 リットル/分の条件
で、室温から 300 °C まで昇温し、その温度で 24 時間保持して予備焼

成した後、550°Cまで昇温し、その温度で9時間保持して本焼成した。本焼成後、室温まで冷却し、焼成粒子を取り出した。この焼成粒子について水中に分散させた後に一定時間放置すると、最も多く含まれている粒子群を含む層と、それよりも大きい粒子のみおよびそれより小さい粒子のみをそれぞれ含む層の三層に分かれる状態になる。その状態で、まず小さい粒子の層を抽出、除去する操作を、その層が透明になるまで繰り返し行い、目的粒子より小さい粒子を除去した。残された層については、粒子のない透明な上澄み液との界面近傍は、体積による沈降速度の違いにより目的粒子のみ含まれているので、この部分を抽出する操作を繰り返し、目的粒子のみを分離した。分級後に得られた粒子について、コールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」）にて粒径測定を行ったところ、平均粒子径が11.93 μmであり、CV値が1.75%であった。

実施例3 (第1の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

15 (1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000gに、1モル／リットルアンモニア水0.8ミリリットル(NH₃ : 2.7 ppm)、MTMS 500gを添加して25°Cにて100 rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、薄く白濁していた。これをシード粒子形成用液とした。

20 (2) シード粒子の形成

攪拌速度を30 rpmに下げ、上記(1)で調製したシード粒子形成用液に1モル／リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加20分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、該シード粒子液におけるシード粒子の粒子径をコールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」）にて測定した。その結果、シード粒子は、平均粒子径が7.184 μmであり、CV値は2.37%であった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水 26,400 g に、MTMS 3,960 g を添加して、30°C にて 100 rpm で攪拌した。約 3 時間後に MTMS は完全に溶解して均一溶液となり、ここにドデシル硫酸ナトリウム 13.2 g を添加した。これを粒子成長用水性溶液とした。

後記するように、本実施例においては、粒径成長用水性溶液を添加後、粒径調整用液を添加したが、この粒径調整用液は以下のようにして調製した。

イオン交換水 8,000 g に、MTMS 1,200 g を添加して、10 室温にて 100 rpm で攪拌した。約 3 時間後に MTMS は完全に溶解して均一溶液となり、これを粒径調整用液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

上記 (3) の粒径成長用水性溶液全量を 20 rpm で攪拌しながら、これに上記 (2) で得られたシード粒子液 5,525 g を添加した。シード粒子液の添加から 30 分後に、粒子成長液 0.2 ミリリットルを 0.1 質量% ポリビニルアルコール水溶液 2 ミリリットルに添加して、コールターカウンター (ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」) で粒子径を測定した。その結果、平均粒子径が 13.37 μm 、CV 値が 1.14 % であり、目的径よりも粒径が少し小さかった。

そこで、上記 (3) の粒径調整用液を定量ポンプで約 40 分間かけて滴下し、上記と同様にしてコールターカウンター (ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」) で粒径成長を観察した。滴下開始から 120 分間に目的とする平均粒子径 14.83 μm (CV 値 0.97 %) が得られた。粒径成長を停止させるために、2.5 質量% アンモニア水 1000 g を定量ポンプにて滴下して熟成を行った。

このようにして得られた粒子の粒子径をコールターカウンター (ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」) にて測定したところ、平均粒子径が 14.80 μm であり、CV 値が 1.93 % であった。

(5) 微小粒子の分級および乾燥

得られた粒子は遠心分離機により固液分離し、その後メタノール中で超音波を照射後、デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残った粒子は風乾したのち、残留メタノールを除去するために150°Cにて乾燥させた。このようにして得られた
5 PMSO粒子の収率は75%であった。

実施例4 (シリカ粒子の製造)

実施例3で得られたPMSO粒子に対して、実施例2と同様な焼成、分級操作を施すことにより、平均粒子径が11.99μmであり、CV値が1.85%の焼成粒子が得られた。

実施例5 (第1の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

(1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000gに、1モル/リットルアンモニア水0.8ミリリットル(NH₃: 2.7ppm)、MTMS 750gを添加して25°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、薄く白濁していた。これをシード粒子形成用液とした。

(2) シード粒子の形成

上記(1)で調製したシード粒子形成用液において、攪拌速度を50rpmに下げて、これに1モル/リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加20分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、該シード粒子液におけるシード粒子の粒子径をコールターカウンター(ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」)にて測定した。その結果、シード粒子は、平均粒子径が11.11μmであり、CV値
25 は2.19%であった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水33,000gに、MTMS 4,950gを添加して、30°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、ここにドデシル硫酸ナトリウム16.5gを添

加した。これを粒径成長用水性溶液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

上記(3)の粒径成長用水性溶液全量を20 rpmで攪拌しながら、これに上記(2)で得られたシード粒子含有溶液5,778 gを添加した。

シード粒子含有溶液の添加から、10分毎に光学顕微鏡ビデオミクロメーター(オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」)で粒子径を測定した。添加から60分後と65分後は、いずれも平均粒子径が約23.6 μm であり、粒径成長が終了したと判断して、2.5質量%アンモニア水1,000 gを定量ポンプにて滴下して熟成を行った。

このようにして得られたポリメチルシリセスキオキサン(PMSO)粒子の粒径分布をコールターカウンター(ベックマン・コールター社製「マルチサイザーニュ」)にて測定した。この粒径分布チャートを図3に示す。該PMSO粒子の平均粒子径は23.30 μm であり、CV値が1.81%であった。

(5) 微小粒子の分級および乾燥

得られた粒子は遠心分離機により固液分離し、その後メタノール中で超音波を照射後、デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残った粒子は風乾したのち、残留メタノールを除去するために150°Cにて乾燥させた。このようにして得られたPMSO粒子の収率は65%であった。

比較例1

(1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000 gに、1モル/リットルアンモニア水0.2ミリリットル(NH₃: 0.68 ppm)、MTMS 500 gを添加して25°Cにて100 rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、透明になった。これをシード粒子形成用液とした。

(2) シード粒子の形成

上記（1）で調製したシード粒子形成用液において、攪拌速度を30 rpmに下げて、これに1モル／リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加20分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、
5 該シード粒子液におけるシード粒子の粒子径をコールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーアル」）にて測定した。その結果、シード粒子は、平均粒子径が2.165μmであり、CV値は3.95%であった。

比較例2

10 (1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000gに、1モル／リットルアンモニア水2.0ミリリットル(NH₃:6.8ppm)、MTMS 500gを添加して25°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後にMTMSは完全に溶解して均一溶液となり、濃い白濁となった。これをシード粒子形成用液とした。

15 (2) シード粒子の形成

上記（1）で調製したシード粒子形成用液において、攪拌速度を30 rpmに下げて、これに1モル／リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加20分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、
20 該シード粒子液におけるシード粒子の粒子径をコールターカウンター（ベックマン・コールター社製「マルチサイザーアル」）にて測定した。その結果、シード粒子は、平均粒子径が2.176μmであり、CV値は4.21%であった。

比較例3

25 (1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5,000gに、MTMS 500gを添加して、25°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、透明になった。これをシード粒子形成用液とした。

(2) シード粒子の形成

上記(1)で調製したシード粒子形成用液において、攪拌速度を30 rpmに下げて、これに1モル/リットルアンモニア水50ミリリットルを一気に添加した。添加30分後のシード粒子液0.2ミリリットルを0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに添加して、該シード粒子液におけるシード粒子の粒子径をコールターカウンター(ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」)にて測定した。その結果、シード粒子は、平均粒子径が2.365μmであり、CV値は1.56%であった。

10 (3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水33,000gに、MTMS 4,950gを添加して、30°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、これを粒径成長用水性溶液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

15 上記(3)の粒径成長用水性溶液全量を20rpmで攪拌しながら、これに上記(2)で得られたシード粒子液3,200gを添加した。

シード粒子液の添加から、10分毎に光学顕微鏡ビデオミクロメーター(オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」)で粒子径を測定した。添加から30分後と35分後は、いずれも平均粒子径が約7.2μmであり、粒径成長が終了したと判断して、2.5質量%アンモニア水500gを定量ポンプにて滴下して、熟成を行った。

このようにして得られたPMSO粒子の粒子径をコールターカウンターにて測定したところ、平均粒子径が7.052μmであり、CV値が1.65%であった。

25 (5) 微小粒子の分級および乾燥

得られた粒子は遠心分離機により固液分離し、その後メタノール中で超音波を照射後、デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残った粒子は風乾したのち、残留メタノールを除去するために150°Cにて乾燥させた。このようにして得られた

PMSO粒子の収率は70%であった。

比較例4

(1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5000gに、MTMS500gを加え、30°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、これをシード粒子形成用液とした。

後記するように、本比較例においては、シード粒子形成用液とともに添加用粒子含有液を用いたが、この添加用粒子含有液は以下のようにして調製した。

イオン交換水450gに、MTMS 45gを加え、室温にて100rpmで攪拌した。MTMS添加当初は、水溶液中に油滴の状態で分散していたが、約2時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となった。攪拌速度を40rpmに下げ、1モル/リットルアンモニア水0.72ミリリットルを一気に添加した。アンモニア水を添加してから15分後には、粒子が成長し、溶液が白濁した。30分後、光学顕微鏡ビデオミクロメーター(オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」)にて粒径を測定したところ、平均粒子径4.1μmであった。

(2) シード粒子の形成

上記(1)で調製したシード粒子形成用液において、攪拌速度を30rpmに下げ、1モル/リットルのアンモニア水50ミリリットルと上記(1)で得られた添加用粒子含有液を493g添加した。添加30分後のシード粒子液0.2ミリリットルを、0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに加え、直ちにコールターカウンター(ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」)で粒子径を測定した。その結果、新たに発生したシード粒子は、平均粒子径4.456μm(CV値1.16%)であった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水33000gに、MTMS4950gを加え、20°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後、MTMSは完全に溶解して均

一な溶液となり、これを粒径成長用水性溶液とした。

(4) 目的粒径の成長およびその後の反応の停止

上記(3)で得られた粒径成長用水性溶液の全量37950gを20rpmで攪拌しながらこれに、上記(2)で得られたシード粒子液の内53410gを添加し、粒子径の成長を行った。

シード粒子液の添加後から10分毎に、光学顕微鏡ビデオミクロメーター(オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」)で粒子径を測定した。添加から1時間後と1時間10分後は、いずれも平均粒子径が約13.8μmであり、また凝集物の発生が確認されたため、粒径10成長が終了したと判断し、2.5質量%アンモニア水500gを定量ポンプにて滴下して熟成を行った。

このようにして得られた粒子の粒子径をコールターカウンター(ベックマン・コールター社製「マルチサイザーIII」)により測定したところ、平均粒子径が13.88μmであり、CV値が1.56%であった。

15 (5) 微小粒子の分級および乾燥

得られた粒子は遠心分離機により固液分離し、その後メタノール中で超音波を照射した後、デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残った粒子は風乾したのち、残留メタノールを除去するために150°Cにて乾燥させた。このようにして得られたPM_{2.5}粒子の収率は30%であった。

比較例5

比較例4で得られたPM_{2.5}粒子に対して、実施例2と同様な焼成、分級操作を施すことにより、平均粒子径が11.31μmであり、CV値が1.47%の焼成粒子が得られた。

25 実施例6 (第2の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

(1) シード粒子形成用液の調製

攪拌装置を据え付けた5000ml容のセパラブルフラスコ中に、イオン交換水2500g、MTMS 250gを加え、30°Cに温度調整した恒温槽内で、100rpmで攪拌した。MTMS添加当初は、水溶

液中に油滴の状態で分散していたが、約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、これをシード粒子形成用液とした。

(2) シード粒子の形成

5 搅拌速度を30 rpmに下げ、上記(1)で調製したシード粒子形成用液に、1モル／リットル アンモニア水25ミリリットルを一気に添加した。アンモニア水を添加してから1分後には、ポリメチルシリセスキオキサン粒子が生成し、溶液が白濁した。

10 添加30分後と40分後にシード粒子液を各0.2ミリリットル採取し、これに0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルを加え、直ちにコールター・カウンター マルチサイザーアイ型(コールター社製)を用い、コールター法で、50000個の粒子の粒径を測定した。その結果、両シード粒子液共に平均粒径は2.85 μm (CV値2.24%)であり、粒子成長が終了していることを確認できたが、目的最終粒径3.00 μm より0.15 μm 小さかった。

15 (3) 粒径成長用水性溶液の調製

搅拌装置を据え付けた5000ml容のセパラブルフラスコ中において、イオン交換水2500g、MTMS250gを加え、30°Cに温度調整した恒温槽内で、100 rpmで搅拌した。MTMS添加当初は、水溶液中に油滴の状態で分散していたが、約3時間後、MTMSは完全20に溶解して均一な溶液となり、これを粒径成長用水性溶液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

目的最終粒径に達しなかった上記(2)のポリメチルシリセスキオキサンシード粒子液に上記(3)の粒径成長用水性溶液を10ミリリットル／分(シード粒子液の体積1ミリリットルに対して0.0036ミリリットル／分)の速度で定量ポンプを用いて滴下、混合を開始した。

粒径が0.15 μm 大きくなるまで、(2)と同様の条件で、コールター法により粒径成長を5分おきに観察した。滴下開始から、粒径成長用水性溶液を900ミリリットル添加した段階で、目的とする3.00 μm (CV値2.07%)のポリメチルシリセスキオキサン粒子が得ら

れていることが分かった。

直ちに粒径成長用水性溶液の添加を止め、25質量%アンモニア水15gとイオン交換水35gの混合溶液を定量ポンプにて滴下して熟成を室温で16時間行った。

5 (5) 微小分級および乾燥

(4)で得られたポリメチルシリセスキオキサン粒子含有溶液を、遠心分離処理して粒子を分離し、その後メタノール中で超音波を照射した後、デカンテーションを行う操作を複数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残ったポリメチルシリセスキオキサン粒子を風乾した10後、残留メタノールを除去するため150°Cに加熱して乾燥させた。

このようにして得られたポリメチルシリセスキオキサン粒子を、(2)と同様にコールター法で粒径測定を行った結果、平均粒径3.00μm(CV値2.01%)であった。

比較例6

15 実施例6の(1)シード粒子形成用液の調製、(2)シード粒子の形成に記載した操作と同内容の操作を行った。

その結果、平均粒径2.85μm(CV値2.24%)のポリオルガノシロキサン粒子が得られたが、目的最終粒径3.00μmより0.15μm小さかった。

20 実施例6と比較例6の対比により、本発明においては、粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を、nmオーダーで粒径調製して製造可能なことが分かる。

実施例7(第2の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

(1) シード粒子形成用液の調製

25 搅拌装置を据え付けた10000ml容のセパラブルフラスコ中に、イオン交換水5000g、MTMS500gを加え、30°Cに温度調整した恒温槽内で、100rpmで搅拌した。MTMS添加当初は、水溶液中に油滴の状態で分散していたが、約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、これをシード粒子形成用液とした。

(2) シード粒子の形成

恒温槽の温度を10°Cに、攪拌速度を30 rpmに下げ、上記(1)で調製したシード粒子形成用液に、1モル/リットル アンモニア水5.0ミリリットルを一気に添加した。アンモニア水を添加してから15分5後には、ポリメチルシリセスキオキサン粒子が生成し、溶液が白濁した。

添加60分後と70分後にシード粒子液を各0.2ミリリットル採取し、これに0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルを加え、直ちに実施例6の(2)と同様にしてコールター法にて、5000個の粒子の粒径を測定した。その結果、両シード粒子液共に平均粒10径は8.20 μm (CV値2.05%) であり、粒子成長が終了していることを確認できたが、目的最終粒径11.00 μmより2.80 μm小さかった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

攪拌装置を据え付けた10000 ml容のセパラブルフラスコ中に、イオン交換水5000 g、MTMS 500 gを加え、30°Cに温度調製15した恒温槽内で、100 rpmで攪拌した。MTMS 添加当初は、水溶液中に油滴の状態で分散していたが、約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一な溶液となった。その後、恒温槽を10°Cに調整し、前記MTMS 溶解溶液が10°Cになるまで攪拌し、これを粒径成長用水性溶液20とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応停止

目的最終粒径に達しなかった上記(2)のポリメチルシリセスキオキサンシード粒子液の半分を、攪拌装置を据え付けた10000 ml容のセパラブルフラスコに慎重に移し換えた後、10°Cに温度調整した恒温槽内で、30 rpmで攪拌した。上記(3)の粒径成長用水性溶液を25 5ミリリットル/分(シード粒子液の体積1ミリリットルに対して0.009ミリリットル/分)の速度で定量ポンプを用いて滴下、混合を開始した。

粒径が2.80 μm大きくなるまで、上記(2)と同様の条件で、コ

ールター法により粒径成長を 5 分おきに観察した。滴下開始から、粒径成長用液を 4 8 0 0 ミリリットル添加した段階で、目的とする 1 1 . 0 0 μm (CV 値 1 . 9 9 %) のポリメチルシリセスキオキサン粒子が得られていることが分かった。

5 直ちに粒径成長用水性溶液の添加を止め、2 5 質量 % アンモニア水 1 5 g とイオン交換水 3 5 g の混合溶液を定量ポンプにて滴下して熟成を室温で 1 6 時間行った。

(5) 微小分級および乾燥

(4) で得られたポリメチルシリセスキオキサン粒子含有溶液を、遠心分離処理して粒子を分離し、その後メタノール中で超音波を照射した後、デカンテーションを行う操作を複数回繰り返すことによって、微小粒子を除去した。残ったポリメチルシリセスキオキサン粒子を風乾した後、残留メタノールを除去するため 1 5 0 °C に加熱して乾燥させた。

15 このようにして得られたポリメチルシリセスキオキサン粒子を、(2) と同様にコールター法で粒径測定を行った結果、平均粒径 1 1 . 0 0 μm (CV 値 1 . 8 1 %) であった。

比較例 7

実施例 7 の (1) シード粒子形成用液の調製、(2) シード粒子の形成に記載した操作と同内容の操作を行った。

20 その結果、平均粒径 8 . 2 0 μm (CV 値 2 . 0 5 %) のポリオルガノシロキサン粒子が得られたが、目的最終粒径 1 1 . 0 0 μm より 2 . 8 0 μm 小さかった。

実施例 7 より、本発明においては、粒径が 1 0 μm を超える大粒径のポリオルガノシロキサン粒子の製造が可能なことが分かり、また実施例 25 7 と比較例 7 との対比により、粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を、nm オーダーで粒径調製して製造可能なことが分かる。

実施例 8 (第 2 の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

目的最終粒径に達しなかった上記実施例 7 の (2) で得られたポリメチルシリセスキオキサンシード粒子液の半分を、攪拌装置を据え付けた

10000 ml容のセパラブルフラスコに慎重に移し換えた後、10°Cに温度調整した恒温槽内で、30 rpmで攪拌した。この溶液に対し、上記実施例7の(3)で調製した粒径成長用水性溶液を50ミリリットル/分(シード粒子液の体積1ミリリットルに対して0.018ミリリットル/分)の速度で定量ポンプを用いて滴下、混合を開始した。

5 粒径が2.80 μm大きくなるまで、実施例7の(2)と同様の条件で、コールター法により粒径成長を5分おきに観察した。滴下開始から、粒径成長用液を4800ミリリットル添加した段階で、目的とする11.00 μm(CV値1.88%)のポリメチルシリセスキオキサン粒子が

10 得られていることが分かった。

直ちに粒径成長用水性溶液の添加を止め、25質量%アンモニア水15 gとイオン交換水35 gの混合溶液を定量ポンプにて滴下して熟成を室温で16時間行った。得られた粒子を光学顕微鏡で観察したところ、気泡粒子の発生が確認された。

15 実施例8より、本発明においては、粒径が10 μmを超える大粒径のポリオルガノシロキサン粒子の製造が可能なことが分かり、また実施例8と比較例7との対比により、粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を、nmオーダーで粒径調製して製造可能なことが分かる。

更に、実施例7と実施例8の対比により、大粒径のポリオルガノシロ20 キサン粒子を製造する場合には、粒径成長用水性溶液の添加速度が、被添加溶液の体積1ミリリットルに対して0.01ミリリットル/分を超える場合には気泡粒子が発生することが分かる。

実施例9 (シリカ粒子の製造)

実施例6で得られた平均粒径が3.00 μmのポリメチルシリセスキ25 オキサン粒子を乾燥させた後、空気流量1リットル/分の条件で、室温から340°Cまで昇温し、その温度で12時間保持して予備焼成したのち、540°Cまで昇温し、その温度で12時間保持して本焼成して、シリカ粒子を得た。本焼成後、室温まで冷却し、焼成粒子を取り出した。この焼成粒子についてコールター法にて観察したところ、平均粒径が2.

50 μm 、CV値が2.10%であった。

実施例10 (第3の態様によるポリオルガノシロキサン粒子の製造)

(1) シード粒子形成用液の調製

イオン交換水5000gに、メチルトリメトキシシラン(MTMS)

5 500gを加え、20°Cにて100rpmで攪拌した。約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となり、これをシード粒子形成用液とした。

後記するように、本実施例においては、シード粒子形成用液とともに添加用粒子含有液を用いたが、この添加用粒子含有液は以下のようにして調製した。

10 イオン交換水450gに、MTMS45gを加え、30°Cにて100rpmで攪拌した。MTMS添加当初は、水溶液中に油滴の状態で分散していたが、約3時間後、MTMSは完全に溶解して均一溶液となった。そして、攪拌速度を30rpmに下げ、1モル/リットルのアンモニア水0.72ミリリットルを一気に添加した。アンモニア水を添加してから15分後には、粒子が成長し、溶液が白濁した。30分後、光学顕微鏡ビデオミクロメーター(オリンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」)にて粒径を測定したところ、平均粒子径4.2 μm であった。

(2) シード粒子の形成

20 上記(1)で調製したシード粒子形成用液を、攪拌速度を30rpmに下げて攪拌しながら、これに1モル/リットルのアンモニア水50ミリリットルと上記(1)で得られた添加用粒子含有液を全量添加してシード粒子含有溶液を得た。添加30分後のシード粒子液0.2ミリリットルを、0.1質量%ポリビニルアルコール水溶液2ミリリットルに加え、直ちにコールターカウンターで粒子径を測定した。その結果、添加粒子が成長したものは、平均粒子径7.380 μm (CV値1.99%)であり、新たに発生した粒子は、平均粒子径(関係式(II)におけるR)4.305 μm (CV値2.54%)であった。

(3) 粒径成長用水性溶液の調製

イオン交換水 33000 g に、MTMS 4950 g と HLB 値 4.0 の
ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) 16.5 g (関係式 (II) における
Y = 0.0435%) を加え、30°C にて 100 rpm で攪拌した。約
3 時間後、MTMS は完全に溶解して均一な溶液となり、これを粒径成
長用水性溶液とした。ここに、関係式 (II) における a は MTMS の加
水分解、縮合生成物 $\text{CH}_3\text{SiO}_{3/2}$ の分子量 67 を MTMS の分子量 1
36 で割ることにより求められ、0.49 であった。

後記するように、本実施例においては、粒径成長用水性溶液を添加後、
粒径調整用液を添加したが、この粒径調整用液は以下のようにして調製
した。

イオン交換水 33000 g に、MTMS 3300 g を加え、30°C に
て 100 rpm で攪拌した。約 3 時間後、MTMS は完全に溶解して均
一な溶液となり、これを粒径調整用液とした。

(4) 目的粒径への成長およびその後の反応の停止

上記 (3) で得られた粒径成長用水性溶液の全量 37966.5 g (関
係式 (II) における A) を 20 rpm で攪拌しながら、これに上記 (2)
で得られたシード粒子含有溶液の内 4144 g を添加し (関係式 (II)
における X = 376.7 g)、粒子径の成長を行った。シード粒子形成
溶液の添加後から 10 分毎に、光学顕微鏡ビデオミクロメーター (オリ
ンパス社製ビデオミクロメーター「VM-50」) で粒子径を測定した。
添加から 1 時間後と 1 時間 10 分後は、いずれも平均粒子径が約 13 μ
m であり、粒径成長が終了したと判断したが、目的粒径に対して微妙に
粒径が足りないことが明らかとなった。そこで、上記 (3) で得られた
粒径調整用液の滴下混合を開始し平均粒径が 0.5 μ m 大きくなるよう
にビデオミクロメーターで確認しながら粒径の調整を行った。滴下開始
から、粒径調整用液を 3800 ミリリットル添加した段階で目的とする
平均粒径 13.5 μ m の粒子が得られていることが分かった。その後 4
5 分間保持した後、25 質量% アンモニア水 500 g を定量ポンプにて
滴下して熟成を室温で 16 時間行った。このようにして得られたポリメ

チルシリセスキオキサン (PMSO) 粒子の粒子径をコールターカウンターにより測定したところ、それぞれが孤立した複数の粒径分布ピークが確認された。その中で、体積換算で 75 % が平均粒子径 13.48 μ m (CV 値 1.72 %) の粒子であった。その他は、6.0 μ m が 14 %、
5 16 μ m が 9 % であった。一方、2 μ m 以下の微小粒子も含まれていたが、その含有量は 1 % にも満たなかった。

ここに関係式 (II) において上記 Y、a、X および R の値に基いて得られる係数 α は 38.5 であった。

(5) 微小分級および乾燥

10 得られた粒子は遠心分離機により合成溶液と分離し、その後メタノール中で超音波を照射した後デカンテーションを行う操作を数回繰り返すことにより微小粒子を除去した。残った粒子は風乾した後、残留メタノールを除去するため 150 °C に加熱して乾燥させた。

実施例 11、13 および比較例 8、9

15 実施例 10 (3) における粒径成長用水性溶液の調製において、ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) の使用量を表 1 に示すように変更した以外は、実施例 10 と同様な操作を行った。これらの結果を実施例 10 の結果とともに表 1 に示す。表 1 より、 α が 4.0 より大きく 75 以下である実施例 10 ~ 12 において、 α が 4.0 に満たない比較例 8 および
20 α が 75 より大きい比較例 9 よりもポリオルガノシロキサン粒子を効率良く製造できることが明らかである。

表 1

		実施例10	実施例11	実施例12	比較例8	比較例9
S D S	添加量	16.5g	2.1g	29.9g	0.27g	35.4g
	Y	0.0435%	0.0055%	0.0787%	0.0007%	0.0932%
使用する原料の理論値	a	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
シード粒子合成に用いた原料の質量(g)	X	376.7	376.7	376.7	376.7	376.7
粒子成長工程に使用する溶液の総質量(g)	A	37966.5	37952.1	37979.9	37950.3	37985.4
シード粒子の粒径(μm)	R	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305
係数α		38.5	4.9	69.7	0.6	82.6
成長粒子の粒径(μm)		13.48	13.59	13.51	14.11	11.96
CV値(%)		1.72	1.80	1.77	2.65	1.96
状態		良好	良好	良好	凝集発生(上記の粒径、CV値は体積換算で40%の粒子の粒径ピークについての値)	目的粒径まで成長せず、反応を停止するためにアンモニアを加えたところ気泡粒子が発生

比較例1以外の粒径、CV値はコールター法にて体積換算で70%以上の粒子についての値を示した。

産業上の利用の可能性

5 本発明のポリオルガノシロキサン粒子の製造方法によれば、平均粒径が例えば10μmより大きく、かつ粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン粒子を製造することができ、この粒子は液晶表示装置、有機エ

レクトロルミネッセンス素子、タッチパネル等のスペーサや標準粒子等の分野で好適に用いることができる。

また、本発明のシリカ粒子の製造方法によれば、上記方法で得られたポリオルガノシロキサン粒子を、特定の条件で焼成処理することにより、
5 液晶表示装置用スペーサや標準粒子などとして好適な粒径を有し、かつ粒径分布が高度に単分散なシリカ粒子を、簡便な操作で短時間に製造することができる。

請求の範囲

1. 一般式 (I)



5 (式中、R¹は非加水分解性基であって、炭素数1～20のアルキル基、
 (メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1～
 20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20の
 アリール基または炭素数7～20のアラルキル基、R²は炭素数1～6
 10 のアルキル基、nは1～3の整数を示し、R¹が複数ある場合、各R¹は
 たがいに同一であっても異なっていてもよく、OR²が複数ある場合、
 各OR²はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)
 で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオ
 ルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含
 有溶液を得る工程(A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式(I)
 15 で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性
 溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程(B)を含み、
 シード粒子含有溶液を得る工程(A)において、前記ケイ素化合物を水
 性媒体に溶解するに際し、該水性媒体に対し、0.7～6.5質量pp
 20 mの塩基性触媒を添加して、予備的に加水分解、縮合させたのち、これ
 に、ポリオルガノシロキサンからなるシード粒子の形成に必要な量の塩
 基性触媒を添加し、該シード粒子を形成させることを特徴とするポリオ
 ルガノシロキサン粒子の製造方法。

2. 塩基性触媒がアンモニアである請求項1に記載の方法。

3. 一般式(I)で表されるケイ素化合物がメチルトリメトキシシラン
 25 またはビニルトリメトキシシランである請求項1または2に記載の方
 法。

4. 製造されたポリオルガノシロキサン粒子の平均粒子径が10μmを
 超え、かつ粒度分布の変動係数(CV値)が5%以下である請求項1な
 いし3のいずれか1項に記載の方法。

5. 一般式 (I)



(式中、 R^1 は非加水分解性基であって、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、(メタ) アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 2 ~ 20 のアルケニル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基または炭素数 7 ~ 20 のアラルキル基、 R^2 は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、 n は 1 ~ 3 の整数を示し、 R^1 が複数ある場合、各 R^1 はたがいに同一であっても異なっていてもよく、 OR^2 が複数ある場合、各 OR^2 はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)

10 で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程 (A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式 (I) で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程 (B) を含み、
 15 シード粒子成長工程 (B) において、連続的あるいは一定時間おきに粒径を測定し、目的粒径に達した時点で反応を停止させることを特徴とするポリオルガノシロキサン粒子の製造方法。

20 6. 連続的あるいは一定時間おきに行われる粒径の測定が、反応溶液の一部を採取し、これと保護コロイド形成剤を接触させて反応溶液中の粒子に保護コロイドを形成させた後、コールター法で行われる請求項 5 に記載の方法。

7. ポリオルガノシロキサン粒子がポリメチルシリセスキオキサン粒子である請求項 5 または 6 に記載の方法。

25 8. 粒径が $10 \mu m$ を超えるポリオルガノシロキサン粒子を得ようとする場合、ケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液の添加速度が、シード粒子含有溶液の体積 1 ミリリットルに対して 0.01 ミリリットル/分以下である請求項 5 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の方法。

9. 最終的に得られたポリオルガノシロキサン粒子の粒径が $1 \sim 30 \mu$

m、変動係数が3%以下である請求項5～8のいずれか1項に記載の方法。

10. 一般式 (I)



5 (式中、R¹は非加水分解性基であって、炭素数1～20のアルキル基、(メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20のアリール基または炭素数7～20のアラルキル基、R²は炭素数1～6のアルキル基、nは1～3の整数を示し、R¹が複数ある場合、各R¹はたがいに同一であっても異なっていてもよく、OR²が複数ある場合、各OR²はたがいに同一であっても異なっていてもよい。)

10 で表されるケイ素化合物を、触媒存在下で加水分解、縮合して、ポリオルガノシロキサン粒子からなるシード粒子を形成させてシード粒子含有溶液を得る工程(A)、および該シード粒子含有溶液と前記一般式(I)で表されるケイ素化合物またはその加水分解物を含む粒径成長用水性溶液とを混合して、前記シード粒子の成長を行う工程(B)を含み、シード粒子成長工程(B)において、アニオン性界面活性剤を関係式(II)

$$Y = \alpha \times (a \times X) / (A \times R) \dots (II)$$

20 ただし、aはケイ素化合物が加水分解、縮合した後の生成物の分子量をケイ素化合物の分子量で割った理論値

Yは粒径成長用水性溶液中におけるアニオン性界面活性剤の濃度(質量%)

Xはシード粒子合成に使用する原料の質量(g)

25 Aはシード粒子成長工程(B)に使用する溶液の総質量(g)

Rはシード粒子の平均粒径(μm)

αは係数で、4.0 < α ≤ 7.5

を満たす濃度でシード粒子含有溶液に添加して、シード粒子を成長させることを特徴とするポリオルガノシロキサン粒子の製造方法。

11. アニオン性界面活性剤が、H L B 値 1 5 ~ 4 0 のものである請求項 10 に記載の方法。

12. アニオン性界面活性剤が高級アルコール硫酸エステル塩である請求項 11 に記載の方法。

5 13. 高級アルコール硫酸エステル塩がドデシル硫酸ナトリウムである請求項 12 に記載の方法。

14. シード粒子形成工程 (A) において、別途作製したポリオルガノシロキサン粒子含有溶液をケイ素化合物を含む反応系に添加し、ポリオルガノシロキサン粒子の存在下でケイ素化合物を加水分解、縮合させてシード粒子を形成させる請求項 10 ないし 13 のいずれか 1 項に記載の方法。

15. ポリオルガノシロキサン粒子が、平均粒子径 1 0 μm を超えるものである請求項 10 ないし 14 のいずれか 1 項に記載の方法。

16. 請求項 1 ないし 15 のいずれか 1 項に記載の方法で得られたポリオルガノシロキサン粒子を、その中に含まれる有機基の分解温度より 150 °C 低い温度以上で、かつ当該有機基の分解温度未満の範囲において予備焼成した後、当該有機基の分解温度以上の温度で焼成処理することを特徴とするシリカ粒子の製造方法。

BEST AVAILABLE COPY

図 1

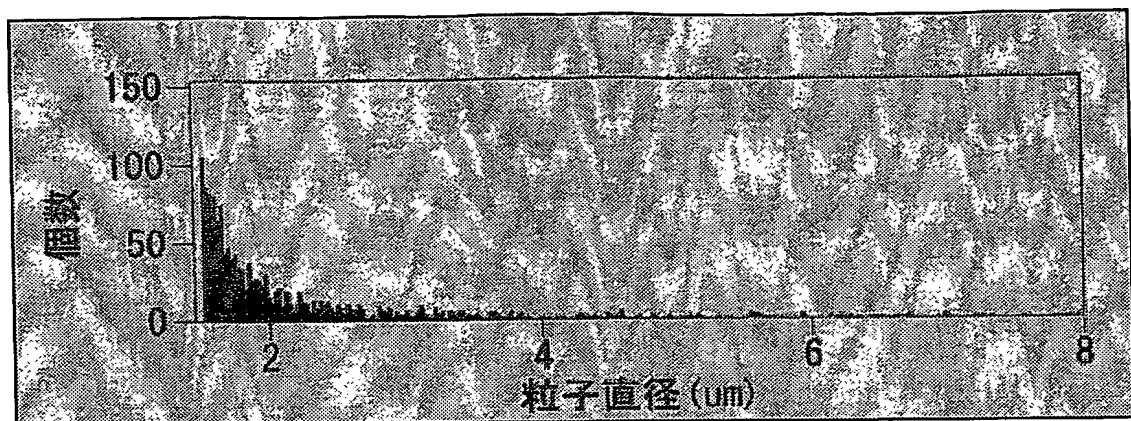
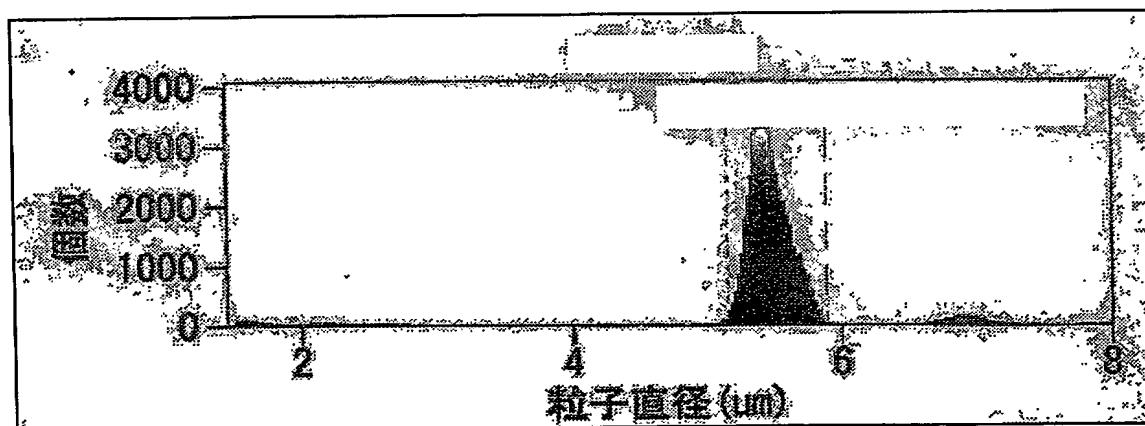
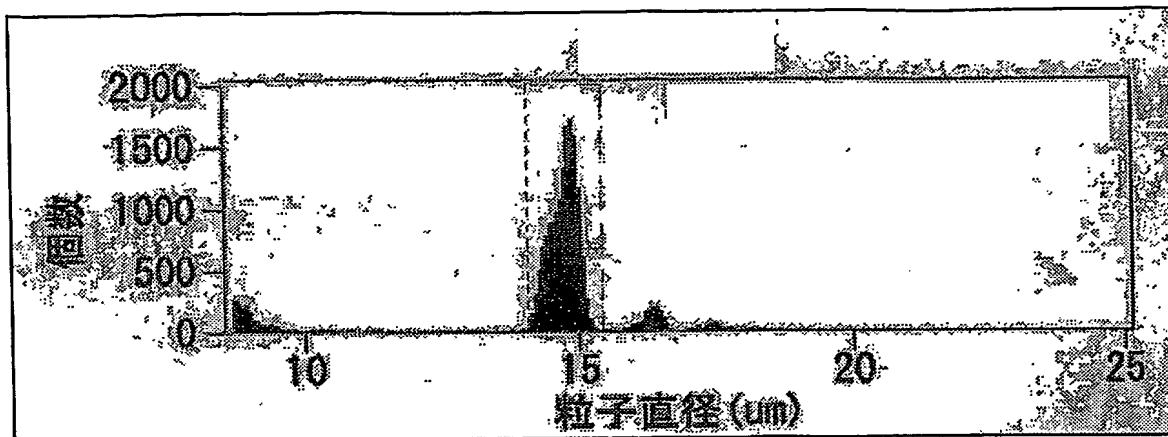


図 2



BEST AVAILABLE COPY

図 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/002130

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08G77/06, C01B33/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08G77/00-77/62, C01B33/00-33/193

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
WPI/L, CAS ONLINE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-80598 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 19 March, 2002 (19.03.02), Claims 1 to 2, 5; Par. Nos. [0020], [0039] (Family: none)	5-9, 16
Y1		1-4
Y2		10-15
Y1	JP 4-88023 A (Toray Industries, Inc.), 19 March, 1992 (19.03.92), Claims 1 to 2; page 2, lower right column, line 7 to page 3, upper left column, line 11 (Family: none)	1-4
Y2	JP 2000-204168 A (Catalysts & Chemicals Industries Co., Ltd.), 25 July, 2000 (25.07.00), Claims 1, 3, 5; Par. Nos. [0022] to [0023], [0026] (Family: none)	10-15

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"&" document member of the same patent family

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

Date of the actual completion of the international search
21 May, 2004 (21.05.04)Date of mailing of the international search report
08 June, 2004 (08.06.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/002130
--

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y2	JP 2002-38049 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 06 February, 2002 (06.02.02), Claims 4, 6; Par. No. [0030] (Family: none)	10-15
A	JP 2001-302227 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 31 October, 2001 (31.10.01), Claims 1 to 8 (Family: none)	1-16
A	JP 2000-17074 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 18 January, 2000 (18.01.00), Claims 1 to 8 (Family: none)	1-16
A	JP 11-92560 A (General Electric Co.), 06 April, 1999 (06.04.99), Claims 1 to 10 & EP 889071 A1 & US 5801262 A	1-16
A	JP 11-286551 A (Eastman Kodak Co.), 19 October, 1999 (19.10.99), Claim 1 & EP 934965 A2 & US 5936031 A	1-16
A	JP 2002-47348 A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 12 February, 2002 (12.02.02), Claims 1 to 4; Par. Nos. [0016] to [0017] & EP 1178070 A2 & US 2002/0016434 A1	1-16
A	JP 11-152336 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99), Claim 4 (Family: none)	1-16
A	JP 11-116680 A (Ube-Nitto Kasei Co., Ltd.), 27 April, 1999 (27.04.99), Claims 1 to 4 (Family: none)	1-16
A	JP 6-87608 A (Ohara Inc.), 29 March, 1994 (29.03.94), Claim 1; Par. No. [0008] (Family: none)	1-16
A	US 3354095 A (Owens-Illinois, Inc.), 21 November, 1967 (21.11.67), Claims 1 to 13 (Family: none)	1-16
A	JP 2003-171466 A (Nikko Rika Co.), 20 June, 2003 (20.06.03), Claims 5 to 7 (Family: none)	1-16

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl'

C08G 77/06,

C01B 33/18,

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl'

C08G 77/00- 77/62,
C01B 33/00- 33/193,

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI/L
CAS ONLINE

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y1 Y2	JP 2002-80598 A (宇部日東化成株式会社) 2002.03.19, 請求項1~2, 請求項5, 段落[0020], 段落[0039] (ファミリーなし)	5-9, 16 1-4 10-15
Y1	JP 4-88023 A (東レ株式会社) 1992.03.19, 請求項1~2, 第2頁右下欄第7行~第3頁左上欄 第11行(ファミリーなし)	1-4

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21. 05. 2004

国際調査報告の発送日

08. 6. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田 孝泰

4 J 9456

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C(続き) 関連すると認められる文献		関連する請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
Y2	JP 2000-204168 A(触媒化成工業株式会社) 2000.07.25, 請求項1, 請求項3, 請求項5, 段落[0022]～[0023], 段落[0026](ファミリーなし)	10-15
Y2	JP 2002-38049 A(宇部日東化成株式会社) 2002.02.06, 請求項4, 請求項6, 段落[0030](ファミリーなし)	10-15
A	JP 2001-302227 A(宇部日東化成株式会社) 2001.10.31, 請求項1～8(ファミリーなし)	1-16
A	JP 2000-17074 A(宇部日東化成株式会社) 2000.01.18, 請求項1～8(ファミリーなし)	1-16
A	JP 11-92560 A(ゼネラル・エレクトリック・カンパニー) 1999.04.06, 請求項1～10 & EP 889071 A1&US 5801262 A	1-16
A	JP 11-286551 A(イーストマン コダック カンパニー) 1999.10.19, 請求項1 & EP 934965 A2&US 5936031 A	1-16
A	JP 2002-47348 A(信越化学工業株式会社) 2002.02.12, 請求項1～4, 段落[0016]～[0017] & EP 1178070 A2&US 2002/0016434 A1	1-16
A	JP 11-152336 A(宇部日東化成株式会社) 1999.06.08, 請求項4(ファミリーなし)	1-16
A	JP 11-116680 A(宇部日東化成株式会社) 1999.04.27, 請求項1～4(ファミリーなし)	1-16
A	JP 6-87608 A(株式会社オハラ) 1994.03.29, 請求項1, 段落[0008](ファミリーなし)	1-16
A	US 3354095 A(Owens-Illinois, Inc.) 1967.11.21, claim 1～13(ファミリーなし)	1-16
PA	JP 2003-171466 A(日興リカ株式会社) 2003.06.20, 請求項5～7(ファミリーなし)	1-16